Future Technologies From MATSUE

同時開催シンポジウム:
電気学会 センサ・マイクロマシン部門大会
第 43 回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム
日本機械学会マイクロ・ナノ工学部門主催シンポジウム
第 17 回「マイクロ・ナノ工学シンポジウム」
応用物理学会集積化 MEMS 技術研究会主催
第 18 回「集積化 MEMS シンポジウム」
化学とマイクロ・ナノシステム学会主催 第 55 回研究会
https://www.sensorsymposium.org/

技術展示出展者・スポンサーシップ募集のご案内

出展者特典を是非ご活用ください
「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム無料参加1名分(通常展示 A の場合は2名), 出展者プレゼンテーション枠使用権, ホームページへのロゴ掲載, 来場者向けプログラム小冊子への広告掲載(オプション(有料))
※ 早期特典として, 7 月 3 日(金)までにお申込の場合, アカデミック展示以外の出展者は
シンポジウム無料参加枠が 2 倍となります

拝啓 ますますご清栄にてご活躍の事とお慶び申し上げます。

電気学会センサ・マイクロマシン部門(E部門)では2013年より部門大会として「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウムを開催しております。本シンポジウムは, 広く関連学協会のご協力をいただき, 従来の学会の枠を超えた各分野の研究者が集う, センサ・マイクロマシン・応用システムをテーマとした学術集会です。同会場においては, 日本機械学会マイクロ・ナノ工学部門主催の「マイクロ・ナノ工学シンポジウム」, 応用物理学会集積化 MEMS 技術研究会主催の「集積化 MEMS シンポジウム」, 化学とマイクロ・ナノシステム学会主催の研究会が同時に開催されます。さらに例年同様, エレクトロニクス実装学会との協力による企画セッションを予定しております。

現在, センサや MEMS(Micro Electromechanical Systems, マイクロマシン)技術の重要性はますます高まりを見せており, スマートフォン, デジタル機器, 医療・ヘルスケア機器, クルマなどの進歩を大きく支えております。自動運転, IoT(Internet of Things, もののインターネット), 人工知能, バイオなどの注目される技術分野の実用化に伴い, また農業や漁業, さらには流通業用途など, MEMS 技術を用いたセンサの需要が急増しており, MEMS を使わない社会はないと言っても過言ではありません。

つきましては, センサ, MEMS デバイス関係およびその応用システム製品, 各種設計ツール, 製造装置, テスト評価装置, 測定機器, 実装技術関連, 材料, 書籍等を広く参加者にご紹介いただきたいと存じます。

具体的には, ご案内させていただく併設技術展示, およびフォトコンテスト協賛, スポンサーシップがあり, 募集いたします。ぜひ, ご検討下さいますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

Future Technologies From MATSUE
第43回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム
実行委員長 宮島 博志(住友精密工業)
併設行事担当委員 加納 一彦(デンソー)
内貴 崇(ローム)
橋本 英生(住友精密工業)
酒井 賢一(ミライズ テクノロジーズ)

開催概要

https://www.sensorsymposium.org/index_j.html

会議の名称	*Future Technologies From MATSUE*
開催シンポジウム	電気学会 センサ・マイクロマシン部門(E部門)主催 第43回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム 日本機械学会マイクロ・ナノ工学部門主催 第17回マイクロ・ナノ工学シンポジウム 応用物理学会集積化MEMS技術研究会主催 第18回集積化 MEMSシンポジウム 化学とマイクロ・ナノシステム学会主催 第 54 回研究会 第 43 回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム The 43rd SENSOR SYMPOSIUM on Sensors, Micromachines and Applied Systems
開催期日	2026 年 11 月 16 日(月)～11 月 19 日(木) 11 月 16 日～18 日 テクニカルセッション 11 月 19 日 テクニカルツアー
開催場所	くにびきメッセ 〒690-0826 島根県松江市学園南 1 丁目 2-1 TEL:0852-24-1111 https://www.kunibikimesse.jp/access/
主催	電気学会 センサ・マイクロマシン部門(E 部門)
協力	日本機械学会 マイクロ・ナノ工学部門 応用物理学会 集積化 MEMS 技術研究会 化学とマイクロ・ナノシステム学会
協賛(予定)	エレクトロニクス実装学会, 応用物理学会, 計測自動制御学会, システム制御情報学会, 次世代センサ協議会, 精密工学会, センシング技術応用研究会, 電気化学会, 電子情報通信学会, 動物実験代替法学会, 日本機械学会マイクロ・ナノ工学部門, 日本材料学会, 日本信頼性学会, 日本生体医工学会, 日本赤外線学会, 日本表面真空学会, 日本ロボット学会, ニューセラミックス懇話会, マイクロマシンセンター, レーザー学会, 電気学会関連技術委員会
参加者数(予定)	1,200 名
URL	https://www.sensorsymposium.org/

お問い合わせ先 *Future Technologies From MATSUE*
事務局
株式会社セミコンダクタポータル
Tel: 03-6807-3970
sensorsympo_2026@semiconportal.com

会議スケジュール（予定）　＊下記スケジュールは暫定で変更する可能性があります

Day	Code	Slot	開始	期間	M会場 (大展示場1/3)	A会場 (多目的ホール)	B会場 (小ホール)	C会場 (国際会議場)	D会場 (501大会議室)	E会場 (601大会議室)	大展示場2/3	
1日目 (11/16 月)			9:30	0:30	開場					表彰委員会		
	16A1		10:00	0:40	開会式 [白]							
	16A2		10:40	0:40	基調講演1 [白]							
			11:20	0:10	休憩						ポスター掲示 (準備)	技術展示
	16A3	4	11:30	1:00	センサシンポジウム [黄] ファイナリスト1	日本機械学会 [青] 企画講演	化学とマイクロナノシステム学会 [緑]シンポジウム	センサシンポジウム [黄] 設計・製作	センサシンポジウム [黄] マイクロナノシステム		FT合同ポスター掲示 I/II	
			12:30	0:10	休憩							
	16P1		12:40	0:55	出展者による技術展示発表セッション I					集積化MEMS 技術研究会運営委員会		
			13:35	0:10	休憩							
	16P2	6	13:45	1:30	センサシンポジウム [黄] ファイナリスト2	日本機械学会 [青] 表彰式	化学とマイクロナノシステム学会 [緑] 一般セッション	センサシンポジウム [黄] 製造・材料	センサシンポジウム [黄] 計測システム			
			15:15	0:10								
	16P3	6	15:25	1:30	化学とマイクロナノシステム学会 [緑]フラッシュプレゼンテーション1	日本機械学会 [青] フラッシュプレゼンテーション1	応用物理学会 集積化MEMS [桃] シンポジウム	センサシンポジウム [黄] ファイナリスト3	センサシンポジウム [黄] バイオ・ケミカル			
			16:55	0:10								
	16P4		17:05	1:30							FT合同ポスターセッション I (コアタイム)	
			18:35	0:10								
	16P5		18:45	1:15				4学会合同 若手企画 [紫]				
2日目 (11/17 火)	17A1		8:30	0:40	基調講演2 [白]							
			9:10	0:10	休憩							技術展示
	17A2	6	9:20	1:30	日本機械学会 [青] フラッシュプレゼンテーション2	化学とマイクロナノシステム学会 [緑]フラッシュプレゼンテーション2	センサシンポジウム [黄] アクチュエータ	センサシンポジウム [黄] ファイナリスト4	センサシンポジウム [黄] フィジカル		FT合同ポスター掲示 I/II	
			10:50	0:10	休憩							
	17A3		11:00	1:30							FT合同ポスターセッション II (コアタイム)	
			12:30	0:10	休憩							
	17P1		12:40	1:30		出展者による技術展示発表セッション II						
			14:10	0:10	休憩							
	17P2	6	14:20	1:30		日本機械学会 [青] フラッシュプレゼンテーション3	化学とマイクロナノシステム学会 [緑] フラッシュプレゼンテーション3	応用物理学会 集積化MEMS [桃] シンポジウム	センサシンポジウム [黄] バイオ	センサシンポジウム [黄] 実装	FT合同ポスター掲示 III/IV	
			15:50	0:10								
	17P3		16:00	0:40		基調講演3 [白]						
			16:40	0:10	休憩							
	17P4		16:50	1:30						表彰・選考委員会	FT合同ポスターセッション III (コアタイム)	
			18:20	0:10	休憩							
	17P5		18:30	2:00	懇談会 (M会場) [紫]							
3日目 (11/18 水)	18A1	4	8:30	1:20	FT合同招待セッション [白]							
			9:50	0:10	休憩							
	18A2	6	10:00	1:30	化学とマイクロナノシステム学会 [緑] フラッシュプレゼンテーション4	日本機械学会 [青] フラッシュプレゼンテーション4	応用物理学会 集積化MEMS [桃] シンポジウム	センサシンポジウム [黄] ケミカル	企画セッション 調査専門委員会			技術展示
			11:30	0:10	休憩						FT合同ポスター掲示 III/IV	
	18P1		11:40	1:00	出展者による技術展示発表セッション III							
			12:40	0:10	休憩							
	18P2		12:50	1:30							FT合同ポスターセッション IV (コアタイム)	
			14:20	0:10	休憩							
	18P3		14:30	0:40	基調講演4 [白]							
	18P4		15:20	0:50	閉会式 [白] (16:10終了)							
4日目 (11/19 木)	Tour		9:00	7:30	テクニカルツアー (松江・安来・出雲方面) 帰着 16:30 (松江駅・空港バス接続)							

技術分野

1	設計・製作技術・材料	設計，解析，シミュレーション，マイクロナノ材料，材料評価，デバイス評価，加工・プロセス技術，パッケージング技術，マイクロ理工学，マイクロ熱流体，集積化 MEMS 技術，信頼性評価技術，デジタルマニファクチャリング（レーザーマイクロマシンニング，アディティブマニファクチャリング），スマートマニュファクチャリング，AI 支援設計，次世代材料（高分子，生体材料，量子ドット）
2	マイクロナノシステム	マイクロナノアクチュエータ（電磁，静電，圧電，熱，形状記憶合金，柔軟素材，など），各種変換機構，光・RF マイクロシステム，パワーMEMS（エネルギーハーベスティング，マイクロ発電，燃料電池），NEMS，ナノとのインターフェース，CMOS-MEMS，マイクロナノシステムパッケージング技術，真空パッケージ技術，量子デバイス応用，低消費電力システム
3	センサ・アクチュエータシステム	センサ・アクチュエータシステム，センシングアルゴリズム，機械学習連携（AI強化，深層学習，リザバーコンピューティング），デジタルツイン連携，IoT応用，AR/VR/MRへのセンサ応用，ヘルスケアテクノロジー，その他センサ応用一般
4	フィジカルセンサ	機械量センサ(慣性センサ・圧力センサ・ひずみセンサなど)，温度センサ，電気・磁気センサ，光センサ，量子応用素子，センサ材料応用（新規複合材料，ナノ構造など）
5	ケミカルセンサ	化学センシング原理，ガスセンサ，酵素センサ，イオンセンサ，匂いセンサ，味センサ，マイクロ化学センサ，化学センサ用技術（自己修復材料，ナノバイオ複合体など），ケモメトリックス，化学センサ用アルゴリズム（深層学習，ニューラルネットワークなど），化学センサ応用（環境モニタリング，医療応用など）
6	バイオセンサ	Lab-on-a-chip，マイクロ化学システム（microTAS），バイオセンサ，マイクロ流体デバイス，BioMEMS，ウェアラブルバイオセンサ（スキンパッチ型，インプラント型など），生体等検査装置，生体分子計測，生物量子計測，生体情報，バイオイメージング（AI 解析統合など），創薬支援，ドラッグデリバリ，再生医療，ゲノム編集連携，リキッドバイオプシー，POCT，リモート診断技術
7	バイオマイクロナノシステム	BioMEMS，マイクロチャネル，ソフトアクチュエータ，医療デバイス，生体機械インターフェース，再生医療，三次元培養，Organ-on-a-chip / Microphysiological System，細胞操作・解析（AI 解析など），バイオハイブリッドデバイス，核酸操作，生体分子固定化技術，ソフトマター（生体模倣材料など），液滴デバイス，バイオイメージング・計測，生体刺激応答（リアルタイムモニタリングなど）
8	センサマイクロシステム実装技術	センサパッケージング・実装技術，センサ集積化プロセス・実装技術，微細接合技術とデバイス・実装応用，大面積微細加工，ナノデバイスプロセス，フレキシブル・ストレッチャブルデバイス（耐久性・伸縮性材料応用など），ウェアラブルデバイス，チップレット，センサネットワーク（次世代通信対応など），ケミカル・バイオデバイス実装技術
企画セッション		・企画セッション等予定

Future Technologies From MATSUE

併催技術展示の展示規定

展示内容　センサ，MEMS デバイス関係およびその応用システム製品，設計ツール，製造装置定機器，材料，実装技術関係，書籍，その他の展示

開催日程　11 月 16 日（月） 11:20～18:35 展示（予定）
11 月 17 日（火） 9:10～18:20 展示（予定）
11 月 18 日（水） 10:00～14:20 展示（予定）

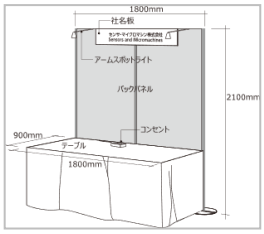
※ポスターセッションコアタイム以外は、常時説明者を置く必要はありません。

出展者プレゼンテーションセッション
（各社 1 回 3～4 分予定。会場等の都合により変更の可能性あり）
11 月 16 日（月） 12:40～13:35 昼食休憩時 （予定）
11 月 17 日（火） 12:40～14:10 昼食休憩時 （予定）
11 月 18 日（水） 11:40～12:40 昼食休憩時 （予定）

展示会規模　50 小間（予定）

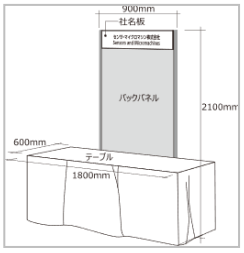
展示スペースと出展料（税別）

①通常展示タイプ A　200,000 円



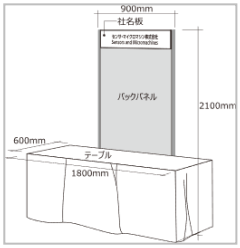
1）バックパネル（クロス貼り，画鋲留め可能，両面テープ不可）
（幅 0.9m 高さ 2.1m，パネル 2 枚組合せ）
2）クロス付きテーブル
（奥行き 0.9m 幅 1.8m 高さ 0.7m）
3）コンセント（100V500W） 1 個 差込口 2 口
4）スポットライト 2 灯
5）社名板（白ベース，黒ゴシック体文字）
（和英併記，幅 0.9m 高さ 0.2m）

②通常展示タイプ B　157,000 円



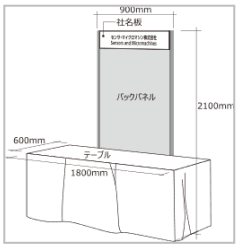
1）バックパネル（クロス貼り，画鋲留め可能，両面テープ不可）
（幅 0.9m 高さ 2.1m，1 枚）
2）クロス付きテーブル
（奥行き 0.6m 幅 1.8m 高さ 0.7m）
3）コンセント（100V500W） 1 個 差込口 2 口
4）社名板（白ベース，黒ゴシック体文字）
（和英併記，幅 0.9m 高さ 0.2m）

③初回展示特別タイプ B　147,000 円



・Future Tech 出展初回のみの特別枠
・展示スペースはタイプ B と同じ
*センサシンポジウムをコアとした Future Technologies 展に初めて出展する機関を対象とします。

④アカデミック展示　57,000 円



1）バックパネル（クロス貼り，画鋲留め可能，両面テープ不可）
（幅 0.9m 高さ 2.1m，1 枚）
2）クロス付きテーブル
（奥行き 0.6m 幅 1.8m 高さ 0.7m）
3）コンセント（100V500W） 1 個 差込口 2 口
4）社名板（白ベース，黒ゴシック体文字）
（和英併記，幅 0.9m 高さ 0.2m）

⑤地元（島根県）特別展示　無料（2 枠選考予定）
展示スペースは，タイプ B からの選択となります

出展者特典　「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム無料参加枠有 ①通常展示 A の場合は 2 名、②B およびアカデミアの場合は 1 名※，出展者プレゼンテーション枠使用権，ホームページへのロゴ掲載，来場者向けプログラム小冊子への広告掲載（オプション（有料）50,000 円税別）無料枠を超えて追加ご参加希望の場合は，1 名様 24,000 円（税込）でご参加頂けます。早期申し込み特典として，**アカデミック展示以外、7 月 3 日（金）までにお申込の場合，シンポジウム無料参加枠が 2 倍**となります。

搬入・搬出
■基礎工事（主催者側工事）
設営：11 月 15 日（日） 13:00～17:00（予定）
撤去：11 月 18 日（水） 15:30～17:30
■搬入・搬出（出展者搬出入時間）
搬入：11 月 15 日（日） 17:00～20:00（予定）
11 月 16 日（月） 9:00～11:00
搬出：11 月 18 日（水） 14:30～15:30
商品搬入・小間装飾を含めて上記時間内で準備を終了してください。小間装飾を含めて上記時間内で施工が完了しないと思われる場合は，展示事務局までご連絡ください。

出展の申込み
出展申込書に必要事項をご記入の上，お申込みください。
事務局から、受領確認とともに、請求書をお送りします。
展示会場のスペースに限りがありますので，各出展申込者からのお申込み総小間数が募集小間数を越えた場合は，申込み小間数を調整することがありますので，予めご了承ください。
出展申込書は会議ホームページにも記載しております。
https://sensorsymposium.org/exhibition/

申込み締切り　10 月 7 日（水）
締切り前にお申込み小間総数が予定小間数に達した場合には，該当日を待たずにお申込みを締め切らせていただくことがございますので，予めご了承ください。

出展料の支払い
出展料は，申込書受領後，事務局より請求書を発行いたします。
請求書の内容に応じて所定の口座にお振り込みください。

出展の取消し
出展申込み後の取消をする場合は，決定後速やかに書面にて，事務局にご連絡ください。ただし，出展料の支払期限以降の返金はいたしかねますので，あらかじめご了承ください。

注意事項

小間割通知
申込み締切り後，主催者は申込み小間数・出展物・展示スペースなどに基づいて小間の調整を行い，10 月 13 日（火）までに配置を決定し，出展者各位に平面図及び小間番号などの詳細を通知いたします。

搬入・搬出
搬入・搬出時間の詳細につきましては，後日ご連絡いたします。

小間内装飾
出展者は注意事項に留意して各自で小間内装飾を行って下さい。詳細は，展示事務局にご相談ください。

電気・備品等
電源・電気器具，備品関係（椅子等の家具類，植物・花，AV 機器等）のオプションのお申込みは，事務局にご相談ください。なお，基礎小間仕様以外の電気使用および追加電気工事費は出展料に含まれておりませんので，各社のご負担となり，後日請求とさせていただきます。

制限事項等
造形物の高さ制限，床工事，床荷重，危険物の持込み制限等，追ってご案内します。

保全と責任
出展者は，その出展物の運搬・搬入・展示中の不測の事故による損失，ならびに出展物により生じる人体の損害については，各自適切な管理を行ってください。
出展者が被った損失・災害に対して主催者は一切責任を負いません。また，天災・ストライキ等不可抗力による展示会の取り消しの場合，主催者はその責任を負いませんのでご了承ください。各出展者の責任において必要な損害保険をおかけください。

この規定に対する変更と追加
この開催規定が定めていない事項またはこの開催規定の条項について異議が生じた場合は，主催者の決定に従うものとします。
また，本技術展示の目的のために必要と判断される場合は出展者に通知し，この規定を改定あるいは追補いたします。

Future Technologies From MATSUE

スポンサーシップの概要と規定

	項目	詳細	費用(税別)
レギュラー スポンサーシップ			100,000 円
	特典	シンポジウム無料参加券(3 日間) 1 名様無料でご聴講頂けます さらに追加ご参加希望の場合は, 1 名様 24,000 円(税込)でご参加頂けます	上記に含まれます
		センサシンポジウム Web サイト・プログラム小冊子へのロゴ掲載	上記に含まれます
		＜オプション(有料)＞ シンポジウム全参加者に配布されるプログラム小冊子(デジタル版予定)への広告スペース使用権 (A4 1 ページ縦サイズ)※	追加 50,000 円
	ストラップ(首掛けホルダー)スポンサーシップ	会期中, 参加者バッジ(首掛け式)ホルダーに社名を記載されたい場合は, 上記スポンサーシップに追加費用でお申し込み頂けます。2 社(機関)までとさせて頂きます。	追加 150,000 円
フォトコンテスト スポンサーシップ		会場入口付近に自社製品の写真や CG, 動画で企業アピールをする作品を常時掲示します。	30,000 円(税別)
	特典	センサシンポジウム Web サイト・プログラム小冊子へのロゴ掲載	上記に含まれます
		＜オプション(有料)＞ シンポジウム全参加者に配布されるプログラム小冊子への広告スペース使用権 (A4 1 ページ縦サイズ)※	追加 50,000 円

スポンサーシップの申込み(オンライン)

スポンサーシップ申込書に必要事項をご記入の上, お申込みください。
事務局から、受領確認とともに、請求書をお送りします。
スポンサーシップ申込書は会議ホームページにも記載しております。
https://sensorsymposium.org/sponsorship/

申込み締切り

2026 年 9 月 25 日(金)
早めにお申込みいただけますと, センサシンポジウムの Website にスポンサー様として, ロゴを掲載し, リンクを貼らせて頂きますので, 効果的です。お早目のお申込みをお薦め申し上げます。

スポンサーシップ料の支払い

スポンサーシップ料は, 申込書受領後, 事務局より請求書を発行いたします。請求書の内容に応じて所定の口座にお振り込みください。

スポンサーシップの取消し

申込み後の取消をする場合は, 決定後速やかに書面にて, 事務局にご連絡ください。但し, 上記申込締切期限以降の返金はいたしかねますので, あらかじめご了承ください。

※ プログラム小冊子(デジタル版)への広告掲載(オプション有料:50,000 円(税別))

スポンサーならびに出展者様だけにご利用いただけるオプションです。シンポジウム開催当日, 全参加者に配布されるデジタル版プログラム小冊子(A4 カラー)への広告を出稿頂けます。

広告仕様: プログラム小冊子サイズ 左右 207mm x 天地 296mm(A4 縦サイズ)
広告サイズ: テキストスペース 左右 186mm x 天地 270mm
ブリードサイズ 左右 202mm x 天地 296mm
フォント:すべてのフォントをアウトライン化
データ形式:PDF、ai、EPS 形式(ファイル名に半角の「%」は使用しないでください。
(カラー、モノクロ、いずれでも結構です)

広告申込締切:9 月 25 日 広告原稿締切: 10 月 9 日(金)

お問い合わせ先

Future Technologies From MATSUE 事務局
株式会社セミコンダクタポータル
Tel: 03-6807-3970 sensorsympo_2026@semiconportal.com